

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-059975

(43)Date of publication of application : 28.02.2003

(51)Int.Cl.

H01L 21/60
H05K 3/34

(21)Application number : 2001-240816 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND
CO LTD

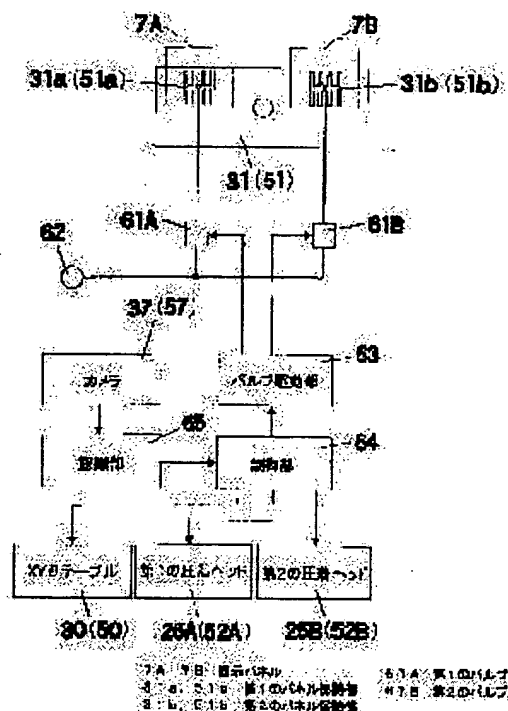
(22)Date of filing : 08.08.2001 (72)Inventor : ONIZUKA YASUTO

(54) BONDING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a bonding method for eliminating apparatus stop due to the mutually relative misalignment in substrates when treating a plurality of substrates simultaneously, and correction work due to manual work, and for improving productivity.

SOLUTION: In the bonding method, display panels 7A and 7B are retained by panel retention sections 31a and 31b provided in a panel support table 31 that is positioned by an XYθ table 30, and alignment to first and second crimp heads 25A and 25B is carried out for crimping individually. The display panel 7A is aligned to the first crimp head for crimping an object to be crimped based on the position detection result of a camera 37 and a recognition section 65, and the display panel 7B is aligned to the second crimping head 25B while the retention state in the display panel 7A is canceled during a crimping process, thus eliminating correction work due to manual work, and improving productivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 25.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3596492

[Date of registration] 17.09.2004

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-59975

(P2003-59975A)

(43) 公開日 平成15年2月28日 (2003.2.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	データ* (参考)
H 0 1 L 21/60	3 1 1	H 0 1 L 21/60	3 1 1 T 5 E 3 1 9
H 0 5 K 3/34	5 0 4	H 0 5 K 3/34	5 0 4 B 5 F 0 4 4

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願2001-240816(P2001-240816)

(22) 出願日 平成13年8月8日 (2001.8.8)

(71) 出願人 000003821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 鬼塚 安登

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 10009/445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

Fターム(参考) 5E319 AA03 BB01 CC61 GG09 GG15

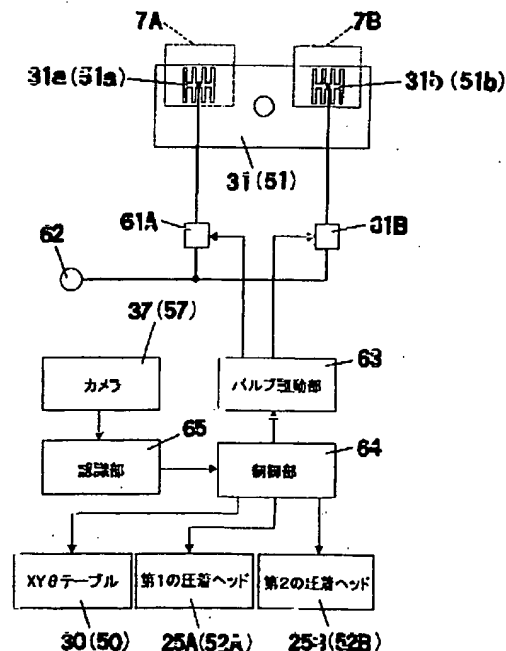
5F044 KK06 PP13

(54) 【発明の名称】 ボンディング方法

(57) 【要約】

【課題】 複数基板を同時処理する場合の基板相互の相対位置ずれに起因する装置停止と手作業による修正作業を排し、生産効率を向上させることができるボンディング方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 X Y θテーブル30によって位置決めされるパネル支持テーブル31に設けられた2つのパネル保持部31a、31bに2枚の表示パネル7A、7Bを保持させ、第1の圧着ヘッド25A、第2の圧着ヘッド25Bに位置合わせして個別に圧着するボンディング方法において、カメラ37、認識部65の位置検出結果に基づいて表示パネル7Aを第1の圧着ヘッドに対して位置合わせして圧着対象物を圧着し、この圧着工程中表示パネル7Aの保持状態を解除した状態で、表示パネル7Bを第2の圧着ヘッド25Bに対して位置合わせする。これにより手作業による修正作業を排し、生産効率を向上させることができる。



7A, 7B 表示パネル
51a, 51b 31のパネル保持部
31a, 31b 32のパネル保持部
61A 第1のパネル
61B 第2のパネル

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも第1の基板と第2の基板を含む複数の基板を個別に保持する保持部が複数設けられ単一の位置決め手段によって少なくとも水平方向に移動する基板支持テーブルと、それぞれの保持部による基板の保持状態を個別に解除する保持解除手段と、前記基板支持テーブル上の複数の基板の位置を検出する位置検出手段と、前記保持部に保持されたそれぞれの基板に対応して配置されそれぞれの基板に圧着対象物を圧着する圧着ヘッドとを備えたボンディング装置によるボンディング方法であって、前記基板支持テーブル上の複数の基板の位置を前記位置検出手段によって検出する位置検出工程と、前記位置検出工程で得られた位置検出結果に基づいて前記位置決め手段により第1の基板をこの第1の基板に対応する圧着ヘッドに対して位置合わせする第1の位置合わせ工程と、前記位置合わせされた第1の基板に対応する圧着ヘッドによって圧着対象物を圧着する第1の圧着工程と、第1の圧着工程中に保持解除手段によって前記圧着中の第1の基板の保持状態を解除する第1の保持状態解除工程と、第1の保持状態解除後に前記位置検出工程で得られた位置検出結果に基づいて前記位置決め手段により第2の基板をこの第2の基板に対応する圧着ヘッドに対して位置合わせする第2の位置合わせ工程と、前記位置合わせされた第2の基板に対応する圧着ヘッドによって圧着対象物を圧着する第2の圧着工程とを含むことを特徴とするボンディング方法。

【請求項2】前記位置検出結果に基づいて前記第1の位置合わせ工程及び第2の位置合わせ工程実行の要否判定を行い、基板の位置ずれが許容範囲内であると判定されたならば全ての基板をそれぞれの基板に対応する圧着ヘッドに対して同時に位置合わせし、基板の位置ずれが許容範囲を越えていると判定されたならば前記第1の位置合わせ工程に移行することを特徴とする請求項1記載のボンディング方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、表示パネルなどの基板にチップを搭載してボンディングするボンディング方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】表示パネルなどの基板には、ドライバ用のチップが実装される。この実装作業は、基板の縁部のチップ実装位置に接着材を介してチップを搭載し、このチップを基板に対して押圧するボンディング工程を経て行われる。近年生産効率を向上させるため、上記作業を行う各ステーションにおいて同時に複数の基板を対象として作業が可能なボンディング装置が用いられるようになっている。

【0003】例えば、チップの固着にACF（異方性導電材）を用いるボンディング装置では、基板の縁部にA

CFテープを貼着するACF貼着ステージ、このACFテープ上にチップを搭載して仮圧着する仮圧着ステージ、仮圧着状態のチップに熱と荷重を加えることによりACFを硬化させ固着する本圧着ステージの各作業ステージにそれぞれ複数の作業ヘッドを備えており、複数の基板に対してこれらの複数の作業ヘッドにより同一作業が並行して行われる。

【0004】このような装置においては、基板はボンディング装置に搬入される前のセンタリング工程で位置合わせされ、複数の基板の相対位置が正しく合わされた状態で作業ステージに搬入される。そして各作業ステージにおいては、これらの基板は同一の基板支持テーブル上に保持され、この状態でこれらの基板の認識を行って位置を検出し、この位置検出結果に従って基板支持テーブルを移動させることにより、複数の基板を同一の位置合わせ動作によって各作業ヘッドに対して位置決めするようにしている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、複数の作業ヘッドを備えたボンディング装置を用いた従来のボンディング方法においては、基板の位置ずれに起因して以下のような不具合が生じる。上述のように搬入前の基板はセンタリングによって相互の相対位置が正しく合わされることが前提となっているが、すべての基板について常に正しく相対位置が合わされるとは限らず、何らかの原因で多少の位置ずれが生じた状態で作業ステージに搬入される場合がある。

【0006】このような場合には、1つの基板については認識による位置検出結果に基づいて位置合わせをすることにより作業ヘッドに対して正しく位置合わせすることが可能であるが、他の基板については前述の位置ずれのため同一の位置合わせ動作によって正しく位置合わせすることができない。

【0007】従来のボンディング方法においては、各作業ステージにおいて各基板の位置検出を行った結果、相対位置が許容範囲を越えて位置ずれを生じている場合には、やむを得ず装置を停止させ作業者が手作業によって位置を修正することにより対処していた。このため位置ずれ発生の度に、装置停止と手作業による修正を必要とし、生産効率の低下を招く結果となっていた。

【0008】そこで本発明は、複数基板を同時処理する場合の基板相互の相対位置ずれに起因する装置停止と手作業による修正作業を排し、生産効率を向上させることができるボンディング方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1記載のボンディング方法は、少なくとも第1の基板と第2の基板を含む複数の基板を個別に保持する保持部が複数設けられ単一の位置決め手段によって少なくとも水平方向に移動する

基板支持テーブルと、それぞれの保持部による基板の保持状態を個別に解除する保持解除手段と、前記基板支持テーブル上の複数の基板の位置を検出する位置検出手段と、前記保持部に保持されたそれぞれの基板に対応して配置されそれぞれの基板に圧着対象物を圧着する圧着ヘッドとを備えたボンディング装置によるボンディング方法であって、前記基板支持テーブル上の複数の基板の位置を前記位置検出手段によって検出する位置検出工程と、前記位置検出工程で得られた位置検出結果に基づいて前記位置決め手段により第1の基板をこの第1の基板に対応する圧着ヘッドに対して位置合わせする第1の位置合わせ工程と、前記位置合わせされた第1の基板に対応する圧着ヘッドによって圧着対象物を圧着する第1の圧着工程と、第1の圧着工程中に保持解除手段によって前記圧着中の第1の基板の保持状態を解除する第1の保持解除工程と、第1の保持解除工程後に前記位置検出工程で得られた位置検出結果に基づいて前記位置決め手段により第2の基板をこの第2の基板に対応する圧着ヘッドに対して位置合わせする第2の位置合わせ工程と、前記位置合わせされた第2の基板に対応する圧着ヘッドによって圧着対象物を圧着する第2の圧着工程とを含む。

【0010】請求項2記載のボンディング方法は、請求項1記載のボンディング方法であって、前記位置検出結果に基づいて前記第1の位置合わせ工程及び第2の位置合わせ工程実行の要否判定を行い、基板の位置ずれが許容範囲内であると判定されたならば全ての基板をそれぞれの基板に対応する圧着ヘッドに対して同時に位置合わせし、基板の位置ずれが許容範囲を越えていると判定されたならば前記第1の位置合わせ工程に移行する。

【0011】本発明によれば、第1の基板と第2の基板を含む複数の基板を単一の位置決め手段によってそれぞれの圧着ヘッドに位置合わせして個別に圧着するボンディング方法において、位置検出工程で得られた位置検出結果に基づいて第1の基板に対応する圧着ヘッドに対して位置合わせして圧着対象物を圧着し、この圧着工程中に保持解除手段によって圧着中の第1の基板の保持状態を解除した状態で、第2の基板に対応する圧着ヘッドに対して位置合わせすることにより、複数基板を同時処理する場合の基板相互の相対位置ずれに起因する装置停止と手作業による修正作業を排し、生産効率を向上させることができる。

【0012】

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の平面図、図2は本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の接着テープ貼付ステージの斜視図、図3は本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の本圧着ステージの斜視図、図4は本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の制御系の構成を示すブロック図、図5、図6、図7、図8、図9、図10は

本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図である。

【0013】まず表示パネルの組立装置の全体構成を図1を参照して説明する。この表示パネルの組立装置は、ガラス基板に接着テープを介してドライバ用の電子部品を圧着することにより表示パネルの組立を行うものである。図1において基台1上には、待機ステージ2、接着テープ貼付ステージ3、電子部品搭載ステージ（仮圧着ステージ）4、本圧着ステージ5及び搬出ステージ6が横一列に配置されている。待機ステージ2は、電子部品がボンディングされる基板である表示パネル7を2枚配置可能なパネル載置テーブル8を備えており、2枚の表示パネル7はパネル載置テーブル8上においてプリセンタ機構（図示せず）によって位置合わせされ、これにより2枚の表示パネル7の相対位置が合わされる。

【0014】接着テープ貼付ステージ3は、XYθテーブル30に装着されたパネル支持テーブル31に2枚の表示パネル7を保持させ、これらの表示パネル7に対して2つの接着テープ圧着ヘッド25A（第1の圧着ヘッド）、25B（第2の圧着ヘッド）によって、表示パネル7の縁部に所定長さの接着テープ22aを貼り付ける。接着テープ圧着ヘッド25A、25Bの下方には下受け部33が配設されており、接着テープ貼り付けの際には、XYθテーブル30を駆動して、パネル支持テーブル31に保持された表示パネル7の縁部を下受け部33上に位置させる。そして表示パネル7の縁部を下受け部33で下受けした状態で、接着テープ圧着ヘッド25A、25Bを下降させ、接着テープ22aの張り付けを行う。

【0015】電子部品搭載ステージ4は、接着テープ貼付ステージ3にて表示パネル7に貼りつけられた接着テープ22aの上にドライバ用の電子部品を搭載して仮圧着する。ここでは、電子部品搭載機構43のインデックステーブル44に設けられた保持ヘッド45を矢印方向に順次インデックス回転させることにより、電子部品供給部42から取り出された電子部品46を、下受け部47上の仮圧着位置まで搬送する。そして仮圧着位置にて保持ヘッド45を下降させることにより、XYθテーブル40に装着されたパネル支持テーブル41によって保持された2枚の表示パネル7に電子部品46を搭載して仮圧着する。

【0016】本圧着ステージ5は、XYθテーブル50に装着されたパネル支持テーブル51に2枚の表示パネル7を保持させ、これらの表示パネル7に仮圧着された電子部品46を、2つの本圧着ヘッド52A（第1の圧着ヘッド）、52B（第2の圧着ヘッド）によって、表示パネル7に本圧着する。本圧着ヘッド52A、52Bの下方には下受け部53が配設されており、本圧着の際には、XYθテーブル50を駆動してパネル支持テーブル51に保持された表示パネル7の縁部を下受け部53

上に移動させる。そして表示パネル7の縁部を下受け部53で下受けした状態で、本圧着ヘッド52A、52Bを下降させ、本圧着を行う。

【0017】搬出ステージ6はパネル搬出テーブル9を備えており、パネル搬出テーブル9には本圧着ステージ5によって本圧着が行われた後の表示パネル7が載置される。また上述の各作業ステージの手前側には、複数のパネル搬送アームを備えた表示パネル搬送機構10が配設されており、表示パネル搬送機構10を駆動することにより、各表示パネル搬送アーム11a、11b、11c、11dによって、それぞれ待機ステージ2から接着テープ貼付けステージ3へ、接着テープ貼付けステージ3から電子部品搭載ステージ4へ、電子部品搭載ステージ4から本圧着ステージ5へ、本圧着ステージ5から搬出ステージ6へ、2枚の表示パネル7をそれぞれ同時に搬送する。そして搬出ステージ6のパネル搬出テーブル9上の表示パネル7は、パネル搬出機構12の搬送アーム11eによって下流側へ搬出される。

【0018】次に図2を参照して、接着テープ貼付ステージ3について説明する。図2において、XY θ テーブル30は、下からYテーブル34、Xテーブル35、 θ テーブル36を順に段積みして構成されており、 θ テーブル36上にはパネル支持テーブル31（基板支持テーブル）が装着されている。パネル支持テーブル31には、基板である表示パネル7を真空吸着によって個別に保持する保持部（第1のパネル保持部31a、第2のパネル保持部31b）（図4参照）が2つ設けられている。

【0019】XY θ テーブル30の上方には、カメラ37がX方向に移動可能に配設されており、カメラ37はパネル支持テーブル31上の2枚の表示パネル7を撮像する。この撮像により、後述するように表示パネル7に設けられたアライメントマークM（図5参照）を認識し、2枚の表示パネル7の位置を検出する。そしてこの位置検出結果に基づいて、XY θ テーブル30を駆動することにより、パネル支持テーブル31は水平方向に移動し、保持した2枚の表示パネル7を後述する第1の接着テープ圧着ヘッド25A、第2の接着テープ圧着ヘッド25Bに位置合わせすることができる。XY θ テーブル30は、パネル支持テーブル31を少なくとも水平方向に移動させる単一の位置決め手段となっている。

【0020】XY θ テーブル30の後方には、下受け部33が配設されている。下受け部33は、接着テープ貼付け時に、表示パネル7の縁部を下方から支持する。下受け部33の上方には、2つのテープ貼付ユニット32A、32Bが配設されている。テープ貼付ユニット32A、32Bは、それぞれ縦フレーム20に、接着テープ供給リール21、接着テープ切断部23、リーダテープ剥離機構24、第1の接着テープ圧着ヘッド25A（または第2の接着テープ圧着ヘッド25B）、リーダ

テープ回収リール28を配置した構成となっている。

【0021】接着テープ供給リール21は巻回状態で収納した積層テープ22を下流側に供給する。積層テープ22は、ベースとなるリーダテープ27に電子部品をボンディングするための接着テープ22aを積層した構成となっている。接着テープ切断部23は積層テープ22に対して進退する切断刃を備えており、この切断刃により接着テープ供給リール21から引き出された積層テープ22のうち接着テープ22aのみを切断する。

【0022】第1の接着テープ圧着ヘッド25A（または第2の接着テープ圧着ヘッド25B）は、積層テープ22の上面に当接して押し下げ表示パネル7の上面に対して押しつけることにより、積層テープ22の下面側の接着テープ22aを表示パネル7に対して圧着する。ここで、テープ貼付ユニット32A、32Bは互いに対称配置となっており、第1の接着テープ圧着ヘッド25Aと第2の接着テープ圧着ヘッド25Bとを極力近接させて配置した構成となっている。

【0023】リーダテープ剥離機構24は、表示パネル7に貼り付けられた状態の接着テープ22aからピン24aによってリーダテープ27を剥離する。リーダテープ回収リール28は、接着テープ22aから剥離された後のリーダテープ27を巻き取って回収する。

【0024】次に図3を参照して、本圧着ステージ5について説明する。図3において、XY θ テーブル50は、下からYテーブル54、Xテーブル55、 θ テーブル56を順に段積みして構成されており、 θ テーブル56上にはパネル支持テーブル51（基板支持テーブル）が装着されている。パネル支持テーブル51は表示パネル7を真空吸着によって保持する保持部（第1のパネル保持部51a、第2のパネル保持部51b）（図4参照）を2つ備えており、それぞれのパネル保持部51a、51bは、表示パネル7を保持する。

【0025】XY θ テーブル50の上方には、カメラ57がX方向に移動可能に配設されており、カメラ57はパネル支持テーブル51上の2枚の表示パネル7を撮像する。この撮像により、後述するように表示パネル7に設けられたアライメントマークを認識し、2枚の表示パネル7の位置を検出する。

【0026】そしてこの位置検出結果に基づいて、XY θ テーブル50を駆動することにより、パネル支持テーブル51は水平方向に移動し、保持した2枚の表示パネル7を後述する本圧着用の第1の本圧着ヘッド52A、第2の本圧着ヘッド52Bに位置合わせすることができる。XY θ テーブル50は、パネル支持テーブル51を少なくとも水平方向に移動させる単一の位置決め手段となっている。

【0027】XY θ テーブル50の後方には、下受け部53が配設されている。下受け部53は、本圧着時に、表示パネル7の縁部を下方から支持する。下受け部53

の上方には、それぞれ下端部に圧着ツール58を備えた第1の本圧着ヘッド52A、第2の本圧着ヘッド52Bが配設されている。電子部品搭載ステージ4で電子部品46が接着テープ上に仮圧着された表示パネル7をそれぞれ対応した第1の本圧着ヘッド52A、第2の本圧着ヘッド52Bに対して位置合わせし、第1の本圧着ヘッド52A、第2の本圧着ヘッド52Bを表示パネル7に対して下降させ押圧状態を所定の圧着時間保持することにより、電子部品46は表示パネル7に本圧着される。

【0028】次に図4を参照して、制御系について説明する。ここでは、接着テープ貼付ステージ3における圧着対象物としての接着テープ22aの貼付動作、本圧着ステージ5における圧着対象物としての電子部品46の本圧着動作を共通の圧着動作とみなし、これらの圧着動作における共通要素を図4に整理して説明する。図4において符号が併記された要素は、これらの2つのステージにおける共通要素を示している。例えば第1の圧着ヘッドは、接着テープ貼付ステージ3においては第1の接着テープ圧着ヘッド25A、本圧着ステージ5においては第1の本圧着ヘッド52Aであり、同様に第2の圧着ヘッドは、接着テープ貼付ステージ3においては第2の接着テープ圧着ヘッド25B、本圧着ステージ5においては第2の本圧着ヘッド52Bに該当する。

【0029】図4において、パネル支持テーブル31(51)には、第1のパネル保持部31a(51a)、第2のパネル保持部31b(51b)が設けられている。第1のパネル保持部31a(51a)、第2のパネル保持部31b(51b)は、パネル支持テーブル31(51)の上面に形成された吸着溝を備えており、表示パネル7を載置した状態でこれらの吸着溝から真空吸引することにより、表示パネル7をパネル支持テーブル31(51)に吸着保持する。

【0030】第1のパネル保持部31a(51a)、第2のパネル保持部31b(51b)は、それぞれ第1のバルブ61A、第2のバルブ61Bに接続され、第1のバルブ61A、第2のバルブ61Bはともに負圧発生源62に接続されている。第1のバルブ61A、第2のバルブ61Bを、制御部64によって制御されるバルブ駆動部63によって開閉駆動することにより、第1のパネル保持部31a(51a)、第2のパネル保持部31b(51b)による表示パネル7の保持及び保持状態解除の切換を個別に行うことができるようになっている。第1のバルブ61A、第2のバルブ61Bは、第1の保持解除手段、第2の保持解除手段となっている。

【0031】カメラ37(57)は認識部65と接続されており、カメラ37(57)によって撮像されたパネル支持テーブル31(51)上の2枚の表示パネル7の撮像データを認識部65によって認識処理することにより、表示パネル7に形成されたアライメントマークMを認識し、これにより2枚の表示パネル7の位置を検出す

ることができる。したがって、カメラ37(57)、認識部65は、パネル支持テーブル31(51)上の複数の表示パネル7の位置を検出する位置検出手段となっている。認識部65による位置検出結果は制御部64に送られる。

【0032】XYθテーブル30(50)、第1の接着テープ圧着ヘッド25A(52A)、第2の接着テープ圧着ヘッド25B(52B)は、制御部64に接続されており、制御部64が表示パネル7の位置検出結果に基づいて、XYθテーブル30(50)、第1の接着テープ圧着ヘッド25A(52A)、第2の接着テープ圧着ヘッド25B(52B)の動作を制御することにより、以下に説明するボンディング動作が実行される。

【0033】この表示パネルの組立装置は上記のように構成されており、以下この表示パネルの組立装置によるボンディング方法について説明する。このボンディング方法は、少なくとも表示パネルAと表示パネルBを含む複数の表示パネル7を個別に保持する保持部が複数設けられ単一の位置決め手段であるXYθテーブルによって少なくとも水平方向に移動するパネル支持テーブル31と、それぞれの保持部による表示パネル7の保持状態を個別に解除する保持解除手段と、パネル支持テーブル31上の複数の表示パネルの位置を検出する位置検出手段と、保持部に保持されたそれぞれの表示パネルに対応して配置されそれぞれの表示パネルに圧着対象物としての接着テープまたは電子部品を圧着する第1の圧着ヘッド(第1の接着テープ圧着ヘッド25A、第1の本圧着ヘッド52A)、第2の圧着ヘッド(第2の接着テープ圧着ヘッド25B、第2の本圧着ヘッド52B)とを備えたボンディング装置(接着テープ貼付けステージまたは本圧着ステージ)によるボンディング方法である。

【0034】ここでは、複数の表示パネルとして、第1の表示パネル(第1の基板)、第2の表示パネル(第2の基板)の2枚の表示パネルを対象とする例を示しており、以下の説明では、これらの表示パネル7を区別するため、表示パネル7A、7Bと表記する。

【0035】以下、図5～図10に沿ってボンディング方法を説明する。ここでは、接着テープ貼付ステージ3、本圧着ステージ5における動作を同一図面で説明するため、共通要素にはそれぞれの符号を併記している。また、第1の接着テープ圧着ヘッド25A、第1の本圧着ヘッド52Aを第1の圧着ヘッドとし、第2の接着テープ圧着ヘッド25B、第2の本圧着ヘッド52Bを第2の圧着ヘッドとして説明する。まず図5(a)において、パネル支持テーブル31(51)上には、表示パネル7A、7Bが前ステージから移載され、それぞれ第1のパネル保持部31a(51a)、第2のパネル保持部31b(51b)によって真空吸着により保持される。

【0036】そしてこの状態で、カメラ37(57)によって表示パネル7A、7Bを撮像し、それぞれアライ

メントマークMを認識する。これにより、表示パネル7A、7Bの位置が検出され、この位置検出結果からそれぞれの表示パネル7A、7Bの位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)、(ΔX_B 、 ΔY_B 、 $\Delta \theta_B$)を求める(位置検出工程)。

【0037】ここで、位置ずれ量の判定を行う。この表示パネルの組立装置においては、接着テープ貼付ステージ3に搬入される2枚の表示パネル7A、7Bは、待機ステージ2にて予め位置合わせが行われ、2パネル間の相対位置が合わされた状態で搬入されるのが前提となっている。しかしながら何らかの原因によって相対位置がずれた状態でこれらの表示パネルが搬入される場合がある。この位置ずれが大きい場合には、同一位置決め動作で2枚の表示パネル7A、7Bを同時に位置合わせすることができないことから、上述の位置検出結果に基づいて以下の判定を行う。

【0038】まず求められた表示パネル7A、7Bの位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)、(ΔX_B 、 ΔY_B 、 $\Delta \theta_B$)が、許容範囲内にあるか否かを判定し、(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)と(ΔX_B 、 ΔY_B 、 $\Delta \theta_B$)の差が小さく、許容範囲内にあると判定されたならば、表示パネル7A、7Bを同一位置合わせ動作によって同時に第1の圧着ヘッド(第1の接着テープ圧着ヘッド25Aまたは第1の本圧着ヘッド52A)、第2の圧着ヘッド(第2の接着テープ圧着ヘッド25Bまたは第2の本圧着ヘッド52B)に対して位置決める。

【0039】すなわち、位置検出結果に基づいてXY θ テーブル30(50)を駆動することにより、表示パネル7A、7Bの縁部を、それぞれ第1の圧着ヘッド、第2の圧着ヘッドの下方の所定位置に移動させる。この場合には、(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)と(ΔX_B 、 ΔY_B 、 $\Delta \theta_B$)との平均値が、XY θ テーブル30(50)による移動時の移動量補正值となる。

【0040】これに対し、求められた表示パネル7A、7Bの位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)、(ΔX_B 、 ΔY_B 、 $\Delta \theta_B$)の差が許容範囲を超え、同一の位置合わせ動作によって表示パネル7A、7Bを同時に許容誤差範囲内で位置合わせすることができないと判断された場合には、以下に説明する個別位置合わせ動作を行う。すなわち、図5(b)に示すように、表示パネル7A(第1の基板)を、位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)に基づいて、第1の圧着ヘッドに対して位置合わせする(第1の位置合わせ工程)。すなわち、XY θ テーブル30(50)を駆動して表示パネル7Aを第1の圧着ヘッドに対して水平移動させる際に、位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)だけ移動量を補正する。これにより、表示パネル7Aの縁部は、第1の圧着ヘッドの下方の所定位置に位置合わせされる。

【0041】次いで、図6(a)に示すように、表示パネル7Aを対象とした圧着を開始する(第1の圧着工

程)。すなわち第1の圧着ヘッドを下降させて、表示パネル7Aを下受け部の上面との間に挟み込む。そしてこの表示パネル7Aの圧着中に、第1のバルブ61Aを閉じて第1のパネル保持部31a(51a)による表示パネル7Aの保持状態を解除する(第1の保持解除工程)。これにより、表示パネル7Aはパネル支持テーブル31(51)に対して水平方向の相対移動が許容された状態となる。

【0042】次いで、表示パネル7B(第2の基板)の位置合わせを行う。すなわち、位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)、(ΔX_B 、 ΔY_B 、 $\Delta \theta_B$)に基づいてXY θ テーブル30(50)を駆動することにより、表示パネル7Bを第2の圧着ヘッドに対して位置合わせする(第2の位置合わせ工程)。ここでは、表示パネル7Aの位置合わせによって、パネル支持テーブル30(50)はカメラ37(57)による位置認識時点における状態から位置ずれ量(ΔX_A 、 ΔY_A 、 $\Delta \theta_A$)に相当する距離・角度だけ既に補正されていることから、($\Delta X_B - \Delta X_A$ 、 $\Delta Y_B - \Delta Y_A$ 、 $\Delta \theta_B - \Delta \theta_A$)が、XY θ テーブル30(50)による新たな移動時の移動量補正量となる。

【0043】そして、図7(a)に示すように、表示パネル7Bを対象とした圧着を開始する(第2の圧着工程)。すなわち第2の圧着ヘッドを下降させて、表示パネル7Bを下受け部の上面との間に挟み込む。その後、表示パネル7A、表示パネル7Bのそれぞれの所定圧着時間が経過したならば、第1の圧着ヘッド、第2の圧着ヘッドを順次上昇させて、圧着状態を解除する。ここで第2の圧着ヘッドは、第1の保持解除工程と第2の位置合わせ工程に要した時間だけ第1の圧着ヘッドよりも遅れて上昇する。そして2つの表示パネル7A、7Bの圧着がともに完了したならば、図7(b)に示すようにXY θ テーブル30(50)を駆動してパネル支持テーブル31(51)を搬送位置まで後退させる。

【0044】そして、接着テープ貼付ステージ3、電子部品搭載ステージ4、本圧着ステージ5の各作業ステージにおいて作業が完了したならば、図8に示すようにパネル支持テーブル31、41、51が搬送位置に復帰する。次いで図9に示すように、パネル搬送機構10が前進し、パネル搬送アーム11a、11b、11c、11dが、それぞれパネル載置テーブル8、パネル支持テーブル31、41、51上に位置する。

【0045】そしてここでパネル搬送アーム11a、11b、11c、11dが上下動することにより、各パネル搬送アームは、それぞれのステージにおいて2つの表示パネル7を保持する。その後、図10に示すように、パネル搬送機構10が右方へ移動することにより、パネル搬送アーム11a、11b、11c、11dは、それぞれパネル支持テーブル31、41、51、パネル搬送テーブル9上に移動する。そしてここで各パネル搬送ア

ームが上下動することにより、パネル支持テーブル31、41、51、パネル搬出テーブル9には、上流側の作業ステージより表示パネル7が搬送される。

【0046】上記説明したように、作業ステージに搬入される複数の表示パネル7の相対位置が許容範囲を超えて位置ずれを生じている場合にあっては、個々の表示パネルを個別に作業ヘッドに対して位置合わせ可能であることから、装置を停止させ作業者が手作業によって位置ずれを修正する必要がある。したがって、複数の表示パネルを同時処理する場合の位置ずれに起因する装置停止と手作業による修正作業を排し、生産効率を向上させることができる。

【0047】なお上記実施の形態では、複数の基板として2枚の表示パネル7を対象とする例を示したが、本発明は3枚以上の基板を対象とする場合にも適用可能である。この場合においても、予め決められている圧着順序に従って、順次圧着ヘッドへの位置合わせ、位置合わせ後の圧着動作を行い、先行基板の圧着中に当該基板の位置保持状態を解除し、パネル保持テーブルの当該基板に対する相対移動を許容した状態で、後続基板の位置合わせを行う。

【0048】

【発明の効果】本発明によれば、第1の基板と第2の基板を含む複数の基板を単一の位置決め手段によってそれぞれの圧着ヘッドに位置合わせして個別に圧着するボンディング方法において、位置検出工程で得られた位置検出結果に基づいて第1の基板を対応する圧着ヘッドに対して位置合わせして圧着対象物を圧着し、この圧着工程中に保持解除手段によって圧着中の第1の基板の保持状態を解除した状態で、第2の基板を対応する圧着ヘッドに対して位置合わせするようにしたので、複数基板を同時処理する場合の基板相互の相対位置ずれに起因する装置停止と手作業による修正作業を排し、生産効率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の平面図

【図2】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置

の接着テープ貼付ステージの斜視図

【図3】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の本圧着ステージの斜視図

【図4】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の制御系の構成を示すブロック図

【図5】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図

【図6】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図

【図7】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図

【図8】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図

【図9】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図

【図10】本発明の一実施の形態の表示パネルの組立装置の動作説明図

【符号の説明】

3 接着テープ貼付ステージ

4 電子部品搭載ステージ

5 本圧着ステージ

7, 7A, 7B 表示パネル

22 積層テープ

22a 接着テープ

25A 第1の接着テープ圧着ヘッド(第1の圧着ヘッド)

25B 第2の接着テープ圧着ヘッド(第2の圧着ヘッド)

30, 50 XYθテーブル

31, 51 パネル支持テーブル

31a, 51a 第1のパネル保持部

31b, 51b 第2のパネル保持部

32A, 32B テープ貼付ユニット

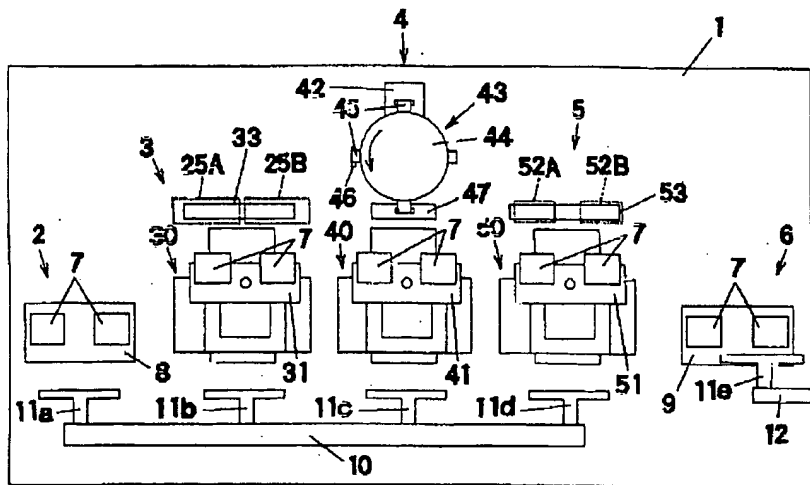
52A 第1の本圧着ヘッド(第1の圧着ヘッド)

52B 第2の本圧着ヘッド(第2の圧着ヘッド)

61A 第1のバルブ

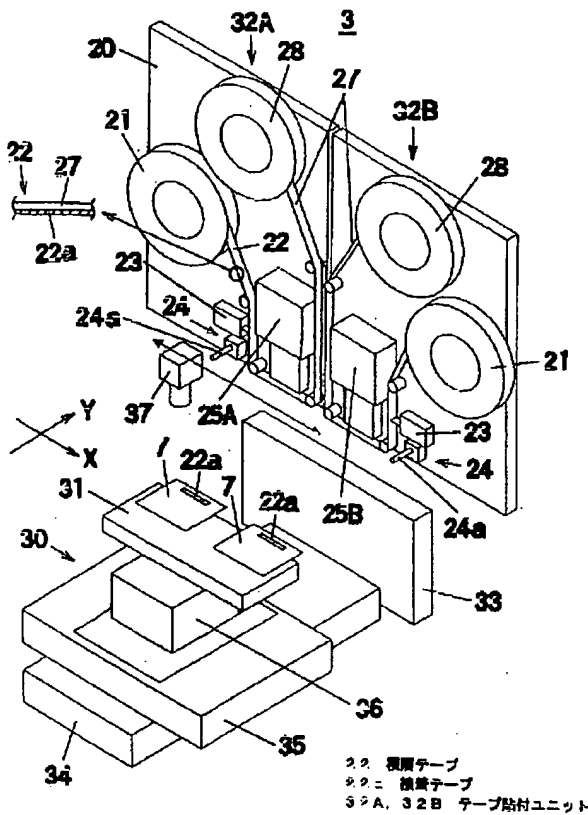
61B 第2のバルブ

【図1】



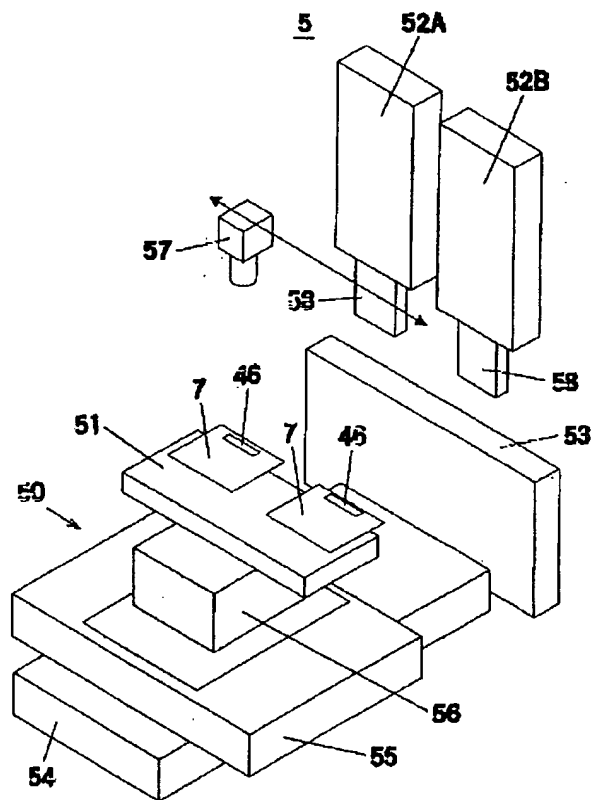
- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 3 接着テープ貼付ステージ | 25B 第2の接着テープ圧着ヘッド |
| 4 電子部品搭載ステージ | 30, 50 XYテーブル |
| 5 本圧着ステージ | 31, 51 パネル支持テーブル |
| 7 表示パネル | 52A 第1の本圧着ヘッド (第1の圧着ヘッド) |
| 25A 第1の接着テープ圧着ヘッド | 52B 第2の本圧着ヘッド (第2の圧着ヘッド) |

【図2】

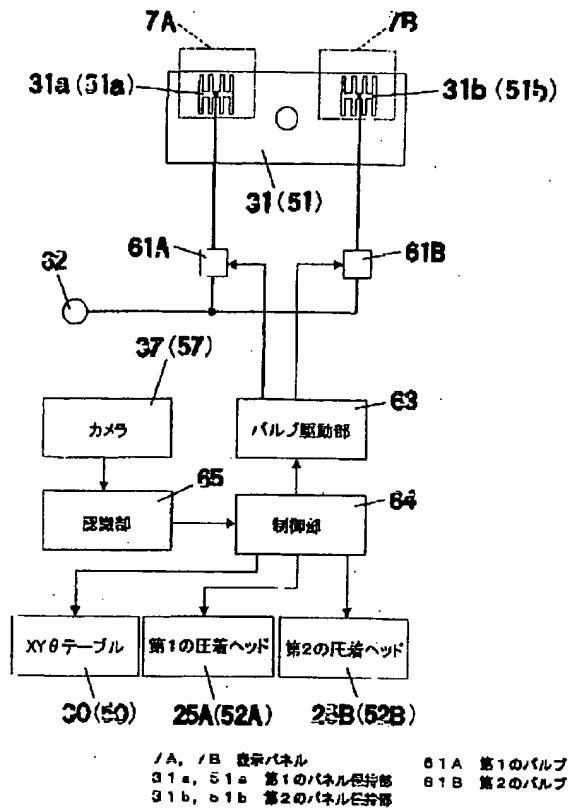


- 22 接着テープ
22a 接着テープ
32A, 32B テープ貼付ユニット

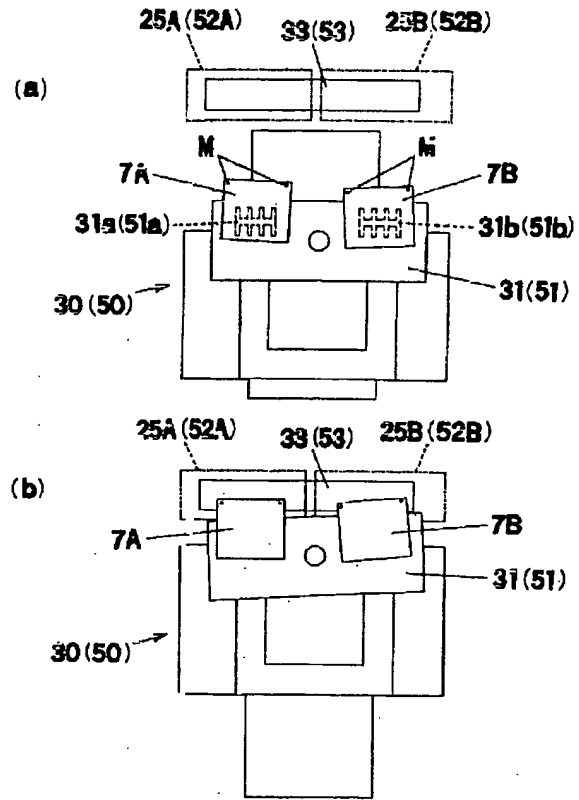
【図3】



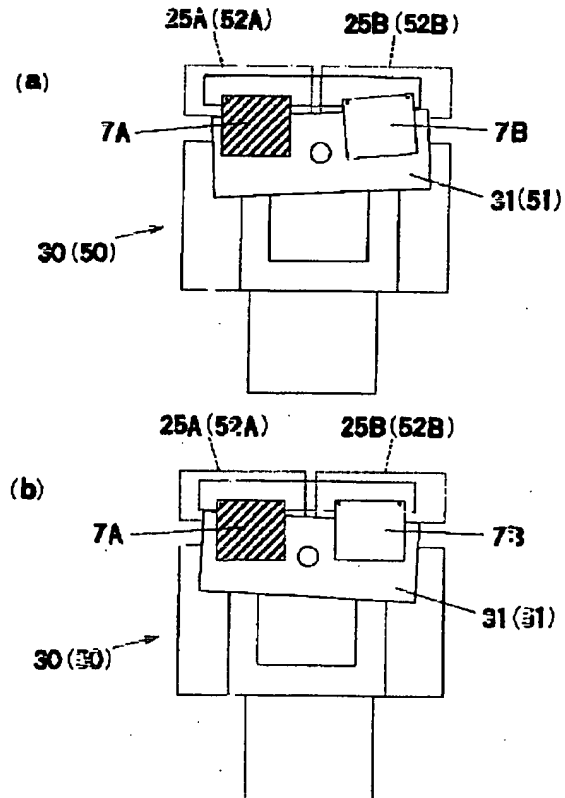
【図4】



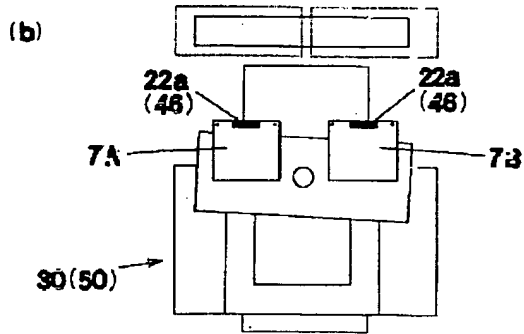
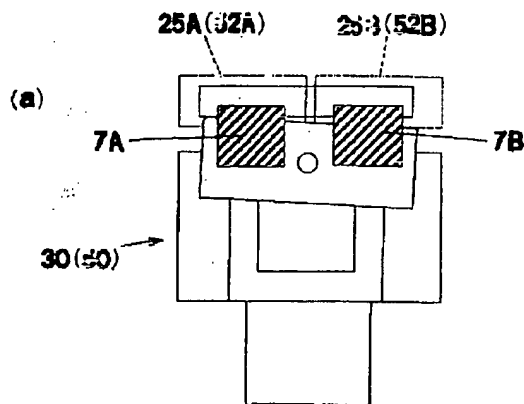
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

